

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<div>☒特定对象调研</div> <div>☐分析师会议</div> <div>☐媒体采访</div> <div>☐业绩说明会</div> <div>☐新闻发布会</div> <div>☐路演活动</div> <div>☒现场参观</div> <div>☐其他（电话会议）</div>
参与单位名称/人员姓名	深圳坤西基金管理有限公司、深圳市前海鸿富投资管理有限公司、深圳锦洋投资基金管理有限公司、广州泽恩投资控股有限公司、广州市激扬企业管理咨询有限公司、深圳市麻王投资集团有限公司
时间	2026年03月12日 14:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书张国光；证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<div><p>1、针对公司的经营情况，公司未来在调整产品结构、提升产品竞争力方面，具体推进哪些工作？</p><p>回复：公司将优化产品结构，提升高功率密度、高附加值产品占比，重点发展车规级功率器件、第三代半导体封装、先进封装相关产品。持续加大研发投入，研发方向聚焦小型化、高功率密度封装、车规级封装、SIP 系统级封装、DFN/QFN 等先进封装工艺，提升产品技术性能。稳固自有品牌业务毛利率优势，围绕市场需求优化自有品牌分立器件与集成电路产品体系；针对封测服务业务，推进工艺优化、产能效率提升、客户与订单结构调整，改善该板块盈利水平，发挥“自有品牌+封测服务”协同效应。</p><p>2、公司目前先进封装技术的应用情况怎么样？</p><p>回复：公司在先进封装领域正积极布局并持续推进技术升级，目前掌握的先进封装技术主要包括 DFN、PDFN、QFN、TSOT 和系统级封装（SiP）等，并已成功应用超薄芯片封装、SiP、倒装焊（Flip Chip）、铜桥键合（Clip Bond）等关键工艺技术。其中，Clip Bond 技术能显著提升产品的大电流和散热性能，Flip Chip 可实现更小封装尺寸和更高可靠性，SiP 则满足多芯片集成需求；在超薄封装方面，公司已突破 80-150 μm 行业难题，这些技术主要服务于功率、电源管理等配套芯片。</p><p>3、面对国产替代的机遇，公司在拓展高端客户方面，有什么具体的计划？</p><p>回复：公司将持续加大先进封装技术投入，聚焦小型化、高功率密度封装、车规级封装等核心研发方向，提升产品性能，匹配高端客户对产品高可靠性、高集成度的需求，为高端客户提供高性能的模拟芯片产品及封测服务。</p><p>公司将聚焦新能源汽车、工业控制、5G 通讯基站、物联网等新兴高景气领域，加快车规级、工业级产品导入上述领域核心应用场景，对接对应领域头部客户，深化与头部客户合作。</p><p>依托公司“分立器件+集成电路”核心封测体系、覆盖 4-12 英寸晶圆全流程的封测能力，丰富的封装产品系列，为高端客户提供分立器件和集成电路的“一站式”服务，发挥全流程服务优势。</p><p>公司将深化与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等高校和科研机构的产学研合作，推动技术成果转化，提升高端产品供给能力，为拓展</p></div>

	<p>高端客户提供产品支撑。</p> <p>4、公司的资本运作计划？</p> <p>回复：公司资本运作将继续围绕产业链上下游延伸与公司主业协同展开，未来将根据整体发展战略，审慎推进并购、股权投资等相关事项。</p> <p>公司拟收购成都芯翼的相关事项，目前还处于推进阶段；本次收购旨在向芯片设计环节延伸产业链，推动公司从封测向“设计+封测”协同发展。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。</p> <p>此外，公司将根据业务发展、项目建设及资本运作的实际需要，合理规划融资安排；实行集中统一、稳健审慎的资金管理模式，保障资本布局的资金需求，维护财务结构稳健。</p> <p>5、近期功率半导体行业在涨价，行业景气度也在提升，公司产品也能用到多个新兴领域，行业涨价对公司产品定价和订单量有什么影响？</p> <p>回复：公司采取成本加成、差异化定价、按客户与产品类别精细化定价的策略，功率半导体行业涨价背景下，公司可通过该定价策略适度传导铜、金等原材料涨价带来的成本压力，针对高附加值功率半导体产品进行精细化定价。</p> <p>行业呈现功率器件需求持续增长的发展趋势，新能源、工业控制、5G 通讯等新兴领域对功率器件的需求提升，公司正稳步推进工业、车规级功率器件产品的客户认证与市场导入，积极拓展上述领域客户与订单。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年03月12日